(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/182890 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/32 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/006323

(22) 国際出願日： 2025年2月25日(25.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-027157 2024年2月27日(27.02.2024) JP
特願 2025-019842 2025年2月10日(10.02.2025) JP

(71) 出願人： 三菱マテリアル株式会社 (**MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 (JP).

(72) 発明者： 松尾 文晴 (**MATSUO Fumiharu**); 〒6691339 兵庫県三田市テクノパーク１２－６ 三菱マテリアル株式会社 三田工場内 (JP).

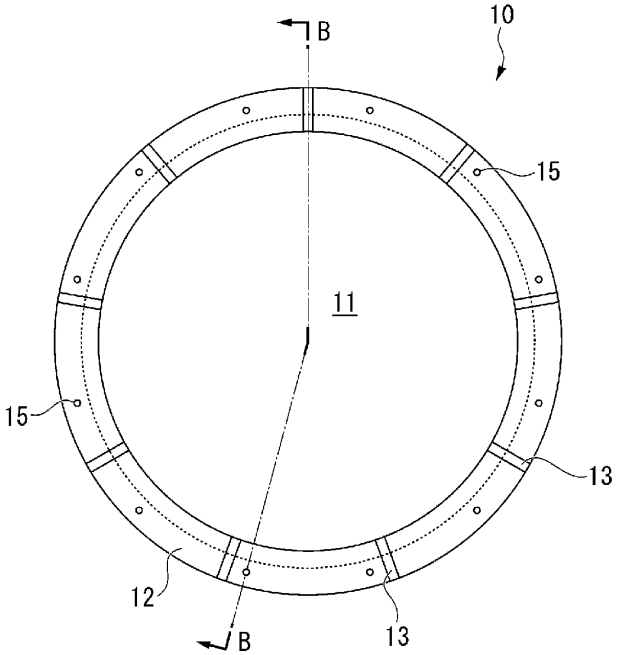
(74) 代理人： 松沼 泰史，外 (**MATSUNUMA Yasushi** et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

WO 2025/182890 A1

(54) **Title:** WAFER-HOLDING RING MEMBER

(54) 発明の名称： ウェハ保持用リング部材



(57) **Abstract:** A wafer-holding ring member (10) for use in a polishing device is characterized by being provided with a polishing surface (12) and by being made from a silicon material. The wafer-holding ring member is preferably made from a silicon material having a purity of 99.9999 mass % or more. The contact angle of water on the polishing surface (12) is preferably 30° or less.

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：研磨装置に用いられるウェハ保持用リング部材（１０）であって、研磨面（１２）を備え、シリコン材料で構成されていることを特徴とする、ウェハ保持用リング部材。純度が９９．９９９９ｍａｓｓ％以上のシリコン材料で構成されていることが好ましい。研磨面（１２）における水の接触角が３０°以下であることが好ましい。